

系選修	SOC(至少0學分)	SOPC設計架構 低功率積體電路設計 系統晶片設計技術 系統晶片測試 車用機電子學 車輛半實物模擬器與電子控制單元設計專題(- 車輛半實物模擬器與電子控制單元設計專題(: 非同步電路設計 計算機演算法 記憶體積體電路設計 混合訊號積體電路設計 軟硬體協同設計 智慧感知與辨識 超大型積體電路佈局設計 超大型積體電路設計 微波積體電路設計 電腦輔助最佳化設計 數位積體電路設計 積體電路設計專題(一) 積體電路設計專題(二) 積體電路測試方法 類比積體電路設計 類比積體電路設計技術	3	3																																
系選修	SOC(至少0學分)	中央處理單元設計 介面設計 系統晶片設計 知識系統 高等作業系統 高等計算機結構 嵌入式系統 嵌入式處理器系統 編譯器設計	3	3																																
先修科目																																				
畢業條件	<p>一. 本系碩士班畢業學分為24學分(不含書報討論、論文指導、專題研究及教育學分)。</p> <p>二. 凡選修本系碩士班或電信所碩士班開設之科目(不限學期), 除第一項所列者外, 一律承認為本系碩士班畢業學分。選修相關系所開設之研究所課程, 經指導教授同意, 得採認為畢業學分(上限6學分)。</p> <p>三. 口試前應完成下列三項要件始可提出學位考試申請:</p> <p>(一)該學期可修畢碩士班規定學分。</p> <p>(二)該學期可修畢大學部應補修學分。</p> <p>(三)研究成果: 至少有一篇研究成果論文被國內外學術期刊或學術性研討會論文集接受刊登, 除教師外, 作者排名序為第一。</p> <p>四. 通過學位論文口試。</p>																																			